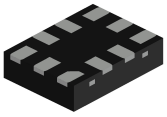
Super Speed スイッチ制御の自律型 USB Type-C コントローラー

FUSB301



Bottom View

X2QFN10 1.6x1.2, 0.4P
CASE 722AC

ORDERING INFORMATION

See detailed ordering and shipping information on page 2 of this data sheet.

概要

FUSB301 は、完全自律型のタイプ C コントローラーで、15 W 未満のアプリケーション用に最適化されています。FUSB301 は、SOURCE モード、SINK モード、DRP、アクセサリー検出サポート、デッドバッテリーサポートのための CC ロジック検出を提供します。 FUSB301 は、プロセッサへの割り込みなしに、外部の USB SuperSpeed スイッチを制御する外部スイッチピン (SS_SW) を搭載します。また FUSB301 は、超低電力のディセーブルモードと通常動作時の低電力を特徴としています。超薄型、 10 リード TMLP パッケージで提供されます。

特長

- 完全自律型 Type–C コントローラー
- Type–C バージョン 1.1 および 1.0 に対応
- V_{DD} 動作範囲、3.0 V ~ 5.5 V
- 低ディセーブル電力：I_{CC} = 2 μA (最大)
- 低スタンバイ電力：I_{CC} = 7 μA (最大)
- DRP モード、オプションのアクセサリーサポート付
- Try.SNK と Try.SRC のサポート機能
- SuperSpeed スイッチ制御
- デッドバッテリーサポート (電力が印加されていない時は SINK モードサポート)
- 2 kV HBM ESD 保護
- 小型パッケージ、10 リード TMLP (1.6 mm x 1.2 mm x 0.375 mm)

アプリケーション

- スマートフォン
- タブレット
- ノートパソコン
- ポータブルアプリケーション

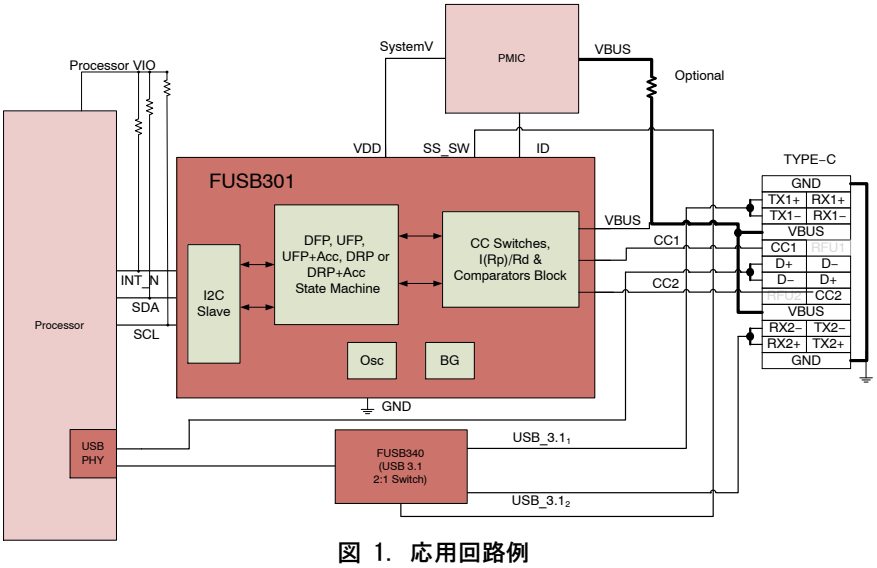


図 1. 応用回路例

© Semiconductor Components Industries, LLC, 2015

注文情報

製品名	トップマーク	動作温度範囲	パッケージ	包装†
FUSB340TMX	NU	–40 to 85°C	10リード・超薄型成形リードレスパッケージ 1.6 mm × 1.2 mm × 0.375 mm	テープ・リール

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D.

ブロック図

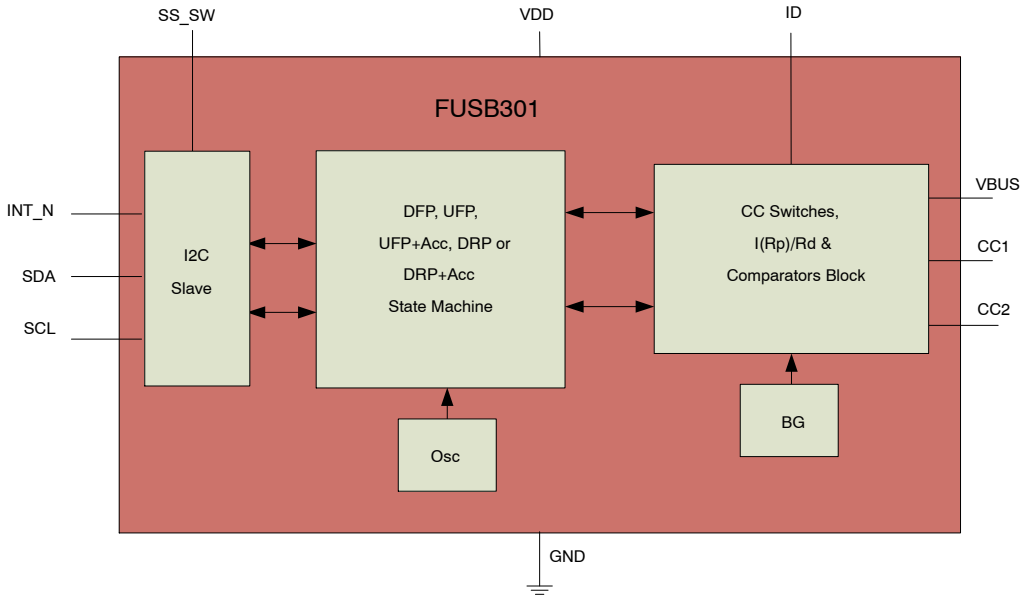


図 2. ブロック図

端子配置

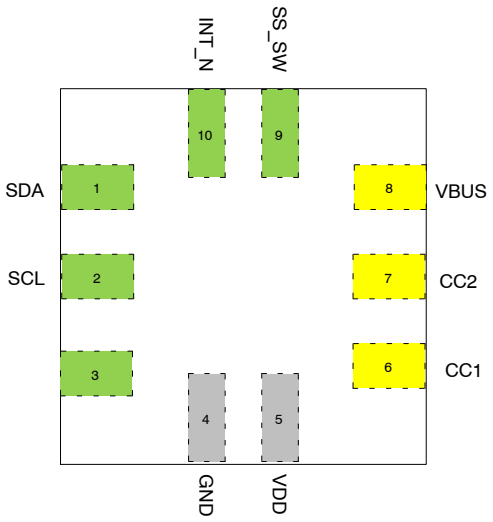


図 3. 端子割り当て (上面からの透視図)

ピン構成

端子番号	名前	種類	概要
USB Type-C コネクターインターフェース			
6, 7	CC1, CC2	I/O	Type-C 設定チャンネル
8	VBUS	入力	脱着検出用の VBUS 入力ピン
4	GND	グランド	グランド
電源インターフェース			
5	VDD	電源	入力電源
信号インターフェース			
1	SDA	入力	I^2C マスター接続用 I^2C シリアルクロック信号
2	SCL	オープンドレーン I/O	I^2C マスター接続用 I^2C シリアルデータ信号
3	ID	オープンドレイン出力	接続されたデバイスが SOURCE あるいは SINK のどちらであるかを検出します。ID ピンはプロセッサ上の USB 2.0 入力とのインターフェースに用いることが可能です。
9	SS_SW	CMOS 出力	プロセッサの割り込みなしで外部の SuperSpeed スイッチコントロール。
10	INT_N	オープンドレイン出力	アクティブローオープンドレイン出力（割り込み : プロセッサに I^2C レジスタビットを読ませるために使用します.

デッドバッテリー

FUSB301 に電源を印加せずに SOURCE デバイスに接続されると、SOURCE は接続ケーブル経由で CC ラインをプルアップします。FUSB301 はそれに反応し、 SOURCE が接続を検出して VBUS をオンにできる範囲まで、CC 電圧を引き下げます。

電源入力、初期化およびリセット、割り込み操作

電源を初めて印加すると、FUSB301 は全ての割り込みをマスクした状態で、SINK モードにて起動します。ローカルプロセッサは FUSB301 を所望のモードに設定し、グローバル割り込みマスクビット、INT_MASK をクリアする必要があります。INT_N ピンはアクティブローのオープンドレーン出力です。このピンは FUSB301 に割り込みが発生しており、対処する必要があることをホストプロセッサに通知します。INT_N ピンは電源投入あるいはデバイスリセット後、デフォルトでハイインピーダンスにされます。グローバル割り込みマスク (制御レジスタ内の INT_MASK) はセットされます。INT_MASK がローカルプロセッサによりクリアされた後、INT_N ピンは将来の割り込みに備えてハイインピーダンスのステートを保ちます。割り込みイベントが発生すると、INT_N はローに駆動され、プロセッサが割り込みレジスタをリードして割り込みをクリアすると、再びハイインピーダンス状態に戻ります。初期の電源投入あるいはリセットの後、システムに電源が既に印加された状態でプロセッサがグローバル割り込みマスクビットに「1」をライトすると、INT_N ピンはハイインピーダンス状態に留まり、グローバル割り込みマスクビットがクリアされるまで全ての割り込みを無視します。グローバル割り込みマスクビットがセットされた状態で、通常は割り込みを起こすイベントが発生すると、グローバル割り込みマスクがクリアされた瞬間に INT_N はローになります。

SuperSpeed スイッチコントロール

SuperSpeed USB スイッチ (USB3.1 Gen 1) が必要なアプリケーションの場合、SS_SW ピンはプロセッサに割り込みをせずに、自動的にその USB スイッチ (例： FUSB340TMX) をコントロールします。

表 1. SUPERSPEED スイッチの真理値表

CC1	CC2	ORIENT1	ORIENT0	SS_SW
未接続	未接続	0	0	ロー
CC に接続		0	1	ロー
	CC に接続	1	0	ハイ
未接続	未接続	1	1	ロー

表 2. ID ピン真理値表

TYPEレジスタ（h12、ビット 4）	概要	ID
SINK = b0	SINK 未検出	ハイインピーダンス (デフォルト)
SINK = b1	SINK 検出済	ロー

絶対最大定格

記号	パラメーター			最小	最大	単位
V_{DD}	VDD からの供給電圧			−0.5	6.0	V
V_{BUS}	VBUS 電源電圧			−0.5	28	V
V_{CC_HDDRP}	SOURCE、SINK、あるいは DRP として設定された場合の CC ピン			−0.5	6.0	V
$T_{STORAGE}$	保存温度範囲			−65	+150	°C
T_J	最大接合温度			–	+150	°C
T_L	リード温度（はんだ付け、10 秒）			–	+260	°C
ESD	IEC 61000−4−2 システム ESD	コネクタピン (VBUS, CC1 & CC2)	気中	15	–	kV
			接触	8	–	
	HBM、JEDEC JESD22−A114	コネクタピン (VBUS, CC1, CC2)		4	–	
		その他		2	–	
	CDM、JEDEC LESD22−C101	全てのピン		1	–	

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
(参考訳)
最大定格を超えるストレスは、デバイスにダメージを与える危険性があります。これらの定格値を超えた場合は、デバイスの機能性を損ない、ダメージが生じ、信頼性に影響を及ぼす危険性があります。

推奨動作条件

記号	パラメーター	最小	標準	最大	単位
V_{BUS}	VBUS 電源電圧	3.7	5.0	21	V
V_{DD}	電源電圧	2.8 (Note 1)	3.3	5.5	V
T_A	動作温度	−40	–	+85	°C

1. この値は機能動作のみであり、以降の電気仕様全てにおける下限を示すものではありません。全ての電気特性は最低 3 V の動作電圧を必要とします。

DC および過渡特性

特に記載のない限り：TA および TJ 推奨温度範囲。特に記載のない限り、全ての通常値は T_A = 25°C および VDD = 3.3 V における値です。

記号	パラメーター	T_A = −40 to +85°C T_J = −40 to +125°C			単位
		最小	標準	最大	
Type−C 固有のパラメーター					
I_{80_CCX}	Source 80 μA CC 電流（デフォルト） HOST_CUR1 = 0, HOST_CUR0 = 1	64	80	96	μA
I_{180_CCX}	Source 180 μA CC 電流 (1.5 A) HOST_CUR1 = 1, HOST_CUR0 = 0	166	180	194	μA
I_{330_CCX}	Source 330 μA CC 電流 (3 A) HOST_CUR1 = 1, HOST_CUR0 = 1	304	330	356	μA
V_{SNKDB}	全プルアップの SOURCE 負荷条件におけるデッドバッテリー内の SINK プルダウン電圧	–	–	2.18	V

DC および過渡特性

特に記載のない限り：TA および TJ 推奨温度範囲。特に記載のない限り、全ての通常値は T_A = 25°C および VDD = 3.3 V における値です。

記号	パラメーター	T_A = −40 to +85°C T_J = −40 to +125°C			単位
		最小	標準	最大	
R_{DEVICE}	VDD が動作範囲内の時のデバイスプルダウン抵抗	4.6	5.1	5.6	kΩ
zOPEN	ディセーブルステートの CC 抵抗	126	–	–	kΩ
vRa−SRCdef	VBUS印加時のデフォルト電流の SOURCE 用 CC ピンにおける Ra 検出しきい値	0.15	0.20	0.25	V
vRa−SRC1.5A	VBUS印加時の 1.5 A 電流の SOURCE 用 CC ピンにおける Ra 検出しきい値	0.35	0.40	0.45	V
vRa−SRC3A	VBUS印加時の 3 A 電流の SOURCE 用 CC ピンにおける Ra 検出しきい値	0.75	0.80	0.85	V
vRd−SRCdef	デフォルト電流の SOURCE 用 Rd 検出しきい値 (HOST_CUR1/0 = 01)	1.50	1.60	1.65	V
vRd−SRC1.5A	1.5 A 電流の SOURCE 用 Rd 検出しきい値 (HOST_CUR1/0 = 10)	1.50	1.60	1.65	V
vRd−SRC3A	3 A 電流の SOURCE 用 Rd 検出しきい値 (HOST_CUR1/0 = 11)	2.45	2.60	2.75	V
vRa−SNK	SINKにおける Ra 検出しきい値	0.15	0.20	0.25	V
vRd−def	SINK におけるデフォルト電流の Rd 検出しきい値	0.61	0.66	0.70	V
vRd−1.5A	SINK における 1.5 A 電流の Rd 検出しきい値	1.16	1.23	1.31	V
vRd−3.0A	SINK における3 A 電流の Rd検出しきい値	2.04	2.11	2.18	V
vVBUSthr	I_VBUSOK 割り込みがトリガーされる VBUS しきい値	3.7	–	–	V

電流消費

記号	パラメーター	V_{DD} (V)	条件	T_A = −40 to +85°C T_J = −40 to +125°C			単位
				最小	標準	最大	
Idisable	ディセーブル時の電流	3.0 ~ 5.5	ディセーブル状態	–	0.35	2.0	μA
Istby	SINK 未接続	3.0 ~ 5.5	何もアタッチされていません	–	3.5	7.0	μA
	Unattached Sink (未接続・SINK) + Acc、SOURCE + Acc、または DRP		何も接続されず、内部でトグルされています	–	5	20	μA
Iattach	接続時電流 (ホスト電流除く)	3.0 ~ 5.5	SINK として接続	–	5	15	μA
			SOURCE として接続	–	10	15	μA

タイミングパラメーター

記号	パラメーター	T_A = −40 to +85°C T_J = −40 to +125°C			単位
		最小	標準	最大	
tCCDebounce	CC のデバウンス時間 (SOURCE またはアクセサリ)	100	150	200	ms
	CC のデバウンス時間 (SINK)	63	75	87	ms
tPDDebounce	CC 取り外し検出のデバウンス時間	10	15	20	ms
tAccDetect	AudioAccessory (オーディオアクセサリ) または DebugAccessory (デバッグアクセサリ) が接続されたことを検出する際のデバウンス時間	50	100	200	ms

タイミングパラメーター (continued)

記号	パラメーター		T_A = −40 to +85°C T_J = −40 to +125°C 最小	標準	最大	単位
tErrorRecovery	ERROR_REC ビット経由あるいはモード変更によって ErrorRecovery (エラー回復) ステートに送られた際、そこに留まる時間		25	50	100	ms
tVBUSondeb	SINK として機能している際の VBUS信号 検出デバウンス時間		0.167	0.200	0.375	ms
tVBUSoffdeb	SINK としての機能が除去された際の VBUS信号検出デバウンス時間		10	15	20	ms
tDRPToggle1	DRP 動作に Unattached.Source (未接続・SOURCE) ステートへ移行する前に Unattached.Sink (未接続・ SINK) に留まる時間	DRPROGGLE = 00	35	–	70	ms
		DRPROGGLE = 01	30	–	60	
		DRPROGGLE = 10	25	–	50	
		DRPROGGLE = 11	20	–	40	
tDRPToggle2	DRP 動作に Unattached.Sink (未接続・SINK) ステートへ移行する前に Unattached.Source (未接続・ SOURCE) に留まる時間	DRPROGGLE = 00	15	–	30	ms
		DRPROGGLE = 01	20	–	40	
		DRPROGGLE = 10	25	–	50	
		DRPROGGLE = 11	30	–	60	

IO 仕様

記号	パラメーター	V_{DD} (V)	条件	T_A = −40 to +85°C T_J = −40 to +125°C 最小	標準	最大	単位
ホストインターフェースピン (ID)							
V_{OLID}	ロー出力電圧	3.0 ~ 5.5	I_{OL} = 4 mA	–	–	0.4	V
ホストインターフェースピン (SS_SW)							
V_{OHSW}	ハイ出力電圧	3.0 ~ 5.5	I_{OH} = −2 mA	$0.7V_{DD}$	–	–	V
V_{OLSW}	ロー出力電圧	3.0 ~ 5.5	I_{OL} = 4 mA	–	–	0.4	V
ホストインターフェースピン (INT_N)							
V_{OLINTN}	ロー出力電圧	3.0 ~ 5.5	I_{OL} = 4 mA	–	–	0.4	V
I2C インターフェース端子 - 高速モード SDA、SCL							
V_{ILI2C}	ローレベル入力電圧	3.0 ~ 5.5		–	–	0.4	V
V_{IHI2C}	ハイレベル入力電圧	3.0 ~ 5.5		1.2	–	–	V
V_{HYS}	シュミットトリガー入力のヒステリシス	3.0 ~ 5.5		0.2	–	–	V
I_{I2C}	SDA および SCL ピンの入力電流	3.0 ~ 5.5	入力電圧 0.26 V to 2 V	−10	–	10	μA
I_{CCTI2C}	SDA または SCL が HIGH の場合の VDD 電流	3.0 ~ 5.5	入力電圧 1.8 V	−10	–	10	μA
V_{OLSDA}	3 mA SINK 電流 (オープンドレーン) におけるローレベル出力電圧	3.0 ~ 5.5		0	–	0.3	V
C_I	各 I/O ピンの容量	3.0 ~ 5.5			–	10	pF

高速モード I2C の仕様（参照図 4)

記号	パラメーター	高速モード		単位
		最小	最大	
f_{SCL}	I2C_SCL クロック周波数	0	400	kHz
$t_{HD;STA}$	ホールド時間（繰り返し）開始条件	0.6	–	µs
t_{LOW}	ロー期間、I2C_SCL クロック	1.3	–	µs
t_{HIGH}	ハイ期間、I2C_SCL クロック	0.6	–	µs
$t_{SU;STA}$	繰り返し開始条件のセットアップ時間	0.6	–	µs
$t_{HD;DAT}$	データホールド時間	0	0.9	µs
$t_{SU;DAT}$	データセットアップ時間 (Note 2)	100	–	ns
t_r	I2C_SDA および I2C_SCL 信号の立ち上がり時間 (Note 3)	20*(V_{DD}/5.5V)	250	ns
t_f	I2C_SDA および I2C_SCL 信号の立ち下がり時間 (Note 3)	20*(V_{DD}/5.5V)	250	ns
$t_{SU;STO}$	停止条件のセットアップ時間	0.6	–	µs
t_{BUF}	停止条件と開始条件間の BUS フリー時間	1.3	–	µs
t_{SP}	入力フィルターが抑止する必要のあるスパイクのパルス幅	0	50	ns

2. 高速モード I²C バスデバイスは標準モード I²C バスシステムにて用いることは可能ですが、$t_{SU;DAT} \geq 250$ ns の要求仕様を満たす必要があります。これは、デバイスが I2C_SCL 信号のロー期間を延長しない場合、自動的に適用されます。そうしたデバイスが I2C_SCL のロー期間を延長する場合、I2C_SDA ラインがリリースされる 1250 ns（tr_max + $t_{SU;DAT}$ = 1000 + 250 = 1250 ns、標準モード I2C バス仕様に基づく）前に、次のデータビットを I2C_SCL ラインに出力する必要があります。
3. Cb は単一バスラインの合計容量を Pf で示します。高速デバイスと混合される場合、I2C 仕様に従い、より高速な立下り時間が可能となります。

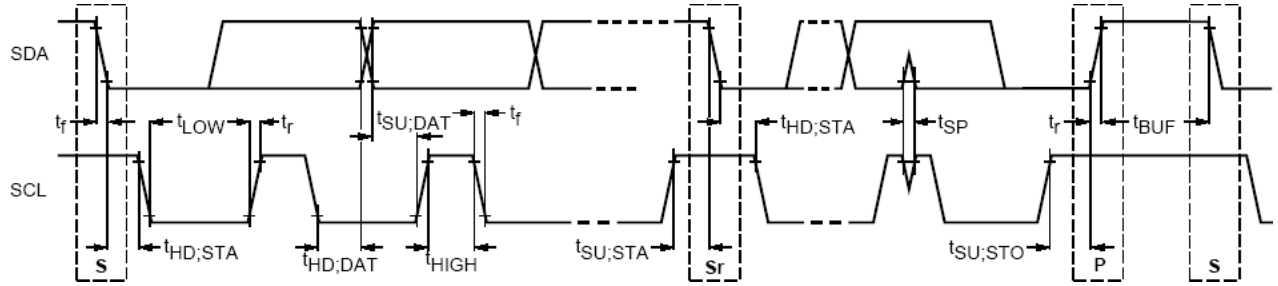
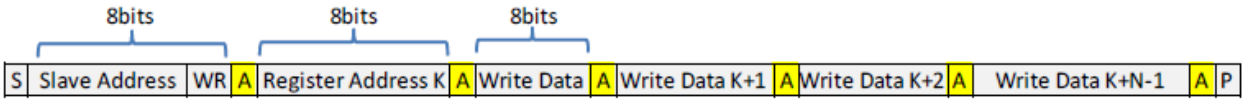


図 4. I²C バス上のフルスピードモードデバイスのタイミング定義

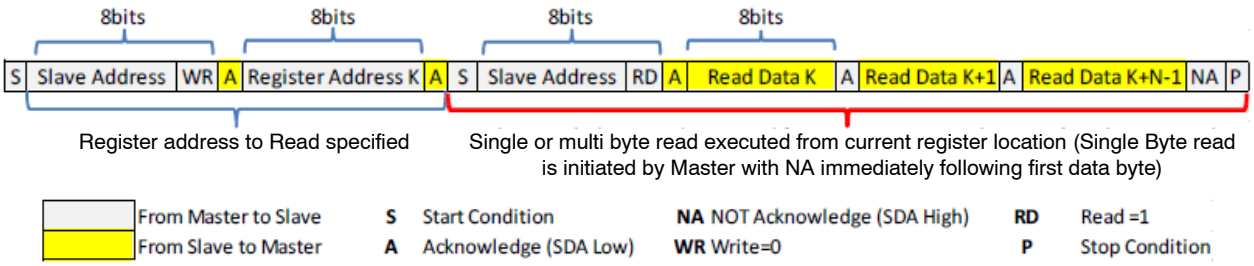
I²C インターフェース

FUSB301 はI²C スレーブコントローラを内蔵します。I²C スレーブは I²C 仕様、バージョン 6 の要件に適合します。このブロックは高速モード向けに設計されています。I²C ライト／リードシーケンスの例はそれぞれ、図 5 と図 6 にて示されています。



NOTE: Single Byte read is initiated by Master with P immediately following first data byte.

図 5. I2C ライト例



NOTE: If Register is not specified Master will begin read from current register. In this case only sequence showing in Red bracket is needed.

図 6. I²C リード例

I²C アドレス

表 3. FUSB301 I²C スレーブアドレス

名前	サイズ (ビット)	ビット 7	ビット 6	ビット 5	ビット 4	ビット 3	ビット 2	ビット 1	ビット 0
Slave Address	8	0	1	0	0	1	0	1	R/W

レジスタ定義

表 4. レジスタマップ

アドレス	レジスタ名	種類	RST Val	ビット 7	ビット 6	ビット 5	ビット 4	ビット 3	ビット 2	ビット 1	ビット 0
0×01	デバイス ID	RO	12	バージョン ID [3:0]				改定 ID [3:0]			
0×02	モード	R/W	04			DRP+ACC	DRP	Sink+ACC	Sink	Source+ACC	Source
0×03	制御	R/W	03			DRPTOGGLE			HOST_CUR1	HOST_CUR0	INT_MASK
0×04	マニュアル	W/C	00					UNATT_SNK	UNATT_SRC	DISABLED	ERROR_REC
0×05	リセット	W/C	00								SW_RES
0×06–0×0F	予約済み	X	xx	使用しないでください							
0×10	マスク	R/W	00					M_ACC_CH	M_BC_LVL	M_DETACH	M_ATTACH
0×11	ステータス	RO	00			ORIENT1	ORIENT0	VBUSOK	BC_LVL1	BC_LVL0	ATTACH
0×12	種類	RO	00				Sink	Source		DEBUGACC	AUDIOACC
0×13	割り込み	R/C	00					I_ACC_CH	I_BC_LVL	I_DETACH	I_ATTACH
0×14–0×1F	予約済み	X	xx	使用しないでください							

4. 空白のレジスタを使用しないでください
5. 未定義のレジスタからリードされた値は無効です。未定義のレジスタへライトしないでください。

表 5. デバイス ID

アドレス：01h
リセット値：0x0001_0010
種類：リードオンリー

ビット番号	名前	サイズ (ビット)	概要
7:4	バージョン ID	4	Trim などの形式に基づくデバイスのバージョン **A_[Version ID]：0001**
3:0	改定 ID	4	各バージョンの改訂履歴 **[Revision ID]_revC：0010**

表 6. モード
アドレス：02h
リセット値：0x0000_0100
種類：リード／ライト

ビット番号 #	名前	サイズ (ビット)	概要
7:6	Reserved	2	使用しないでください
5	DRP+ACC	1	1：デバイスをアクセサリサポート付きの DRP として設定する
4	DRP	1	1：デバイスをアクセサリサポート無しの DRP として設定する
3	Sink+ACC	1	1：デバイスをアクセサリーサポート付きの SINK として設定する
2	Sink	1	**1：デバイスをアクセサリーサポート無しの SINK として設定する**
1	Source+ACC	1	1：デバイスをアクセサリーサポート付きの SOURCE として設定する
0	Source	1	1：デバイスをアクセサリーサポート無しの SOURCE として設定する

表 7. 制御
アドレス：03h
リセット値：0xXX00_X011
種類：リード／ライト

ビット番号	名前	サイズ (ビット)	概要
7:6	予約済み	2	使用しないでください
5:4	DRPTOGGLE	2	Unattached.Sink (未接続・SINK)ステートと Unattached.SOURCE (未接続・SOURCE）ステートの間で異なるタイミングを選択します。 **00：Unattached.Sink (未接続・SINK) を最低 35 ms、Unattached.SOURCE (未接続・SOURCE) を最低 15 ms** 01：Unattached.Sink (未接続・SINK) を最低 30 ms、Unattached.SOURCE (未接続・SOURCE) を最低 20 ms 10：Unattached.Sink (未接続・SINK) を最低 25 ms、Unattached.SOURCE (未接続・SOURCE) を最低 25 ms 11：Unattached.Sink (未接続・SINK) を最低 20 ms、Unattached.SOURCE (未接続・SOURCE) を最低 30 ms
3	予約済み	1	使用しないでください
2:1	HOST_CUR [1:0]	2	1：デバイスが SOURCE として認識された際にプルアップ電流を制御します 00：電流なし **01：80 μA - デフォルト USB モード** 10：180 μA - 1.5 A 電流モード 11：330 μA - 3 A 電流モード
0	INT_MASK	1	**1：全ての割り込みをマスクするグローバル割り込みマスク**

表 8. マニュアルL (Note 6)
アドレス：04h
リセット値：0xXXXX_0000
種類：ライト／クリア

ビット番号	名前	サイズ (ビット)	概要
7:4	予約済み	4	使用しないでください
3	UNATT_SNK	1	1：Type−C 仕様に定義されている通り、デバイスを Unattached.Sink (未接続・SINK) ステートにします
2	UNATT_SRC	1	1：Type−C 仕様に定義されている通り、デバイスを Unattached.Source (未接続・SOURCE) ステートにします
1	DISABLED (Note 7)	1	1：Type−C 仕様に定義されている通り、デバイスをディセーブルステートにします
0	ERROR_REC	1	1：Type− C 仕様に定義されている通り、デバイスを ErrorRecovery (エラー回復) ステートにします

6. 複数のビットが同時に「b1」にセットされる場合、優先順位が適用されます。第一優先は DISABLED、第二優先は ERROR_REC、第三優先は UNATT_ SOURCE 最後は UNATT_SINK です。優先度の最も高いビットの値が選択され、残り全てのビットは自動的にクリアされます。
7. DISABLED ビットは手動でクリアする必要があります。

表 9. リセット
アドレス：05h
リセット値：0xXXXX_XXX0
種類：ライト／クリア

ビット番号	名前	サイズ (ビット)	概要
7:6	予約済み	7	使用しないでください
0	SW_RES	1	1：システムおよび I2C レジスタをリセットします。

表 10. マスク
アドレス：10h
リセット値：0xXXXX_0000
種類：リード／ライト

ビット番号	名前	サイズ (ビット)	概要
7:4	予約済み	4	使用しないでください
3	M_ACC_CH	1	1：Accessory Present (アクセサリ検出済) から Attached Accessory (アタッチされたアクセサリ) への変更をマスクします
2	M_BC_LVL	1	1：I_BC_LVL 割り込みビットの変更をマスクします
1	M_DETACH	1	1：I_DETACH 割り込みビットの変更をマスクします
0	M_ATTACH	1	1：I_ATTACH 割り込みビットの変更をマスクします

表 11. ステータス
アドレス：11h
リセット値：0xXX00_0000
種類：リード

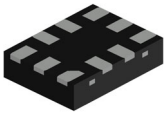
ビット番号	名前	サイズ（ビット)	概要
7:6	予約済み	2	使用しないでください
5:4	ORIENT[1:0]	2	どの CCx ピンへ CC ケーブルが接続されているかのステータスを示します 11：検出中に障害が発生しました 10：ケーブル CC は CC2 ピンを通じて接続されています 01：ケーブル CC は CC1 ピンを通じて接続されています 00：無接続または未解決の接続が検出されました
3	VBUSOK	1	1：VBUS が有効な範囲に収まっていることを示すステータスビットです
2:1	BC_LVL[1:0]	2	CC ライン上の現在のアドバタイズメントを検出するしきい値 00：Ra または未アタッチの SINK 01：SINK デフォルト電流のアドバタイズメントの Rd しきい値 10：SINK 1.5 A 電流のアドバタイズメントの Rd しきい値 11：SINK 3 A 電流のアドバタイズメントの Rd しきい値
0	ATTACH	1	1：Type（種類）レジスタに示されるデバイスまたはアクセサリにアタッチされています

表 12. 種類
アドレス：12h
リセット値：0xXXX0_0X00
種類：リード

ビット番号	名前	サイズ（ビット)	概要
7:5	予約済み	3	使用しないでください
4	Sink	1	1：SINK が検出されたことを示します
3	Source	1	1：SOURCE が検出されたことを示します
2	予約済み	1	使用しないでください
1	DEBUGACC	1	1：デバッグアクセサリが検出されたことを示します
0	AUDIOACC	1	1：オーディオアクセサリが検出されたことを示します

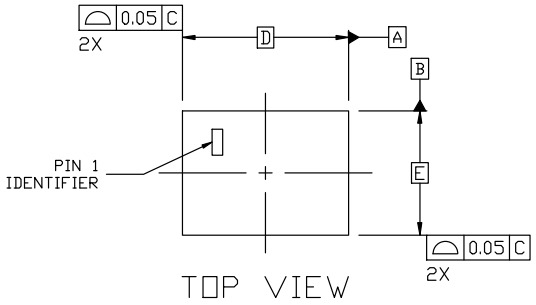
表 13. **INTERRUPT0**
アドレス：13h
リセット値：0xXXXX_X000
種類：ライト／クリア

ビット番号	名前	サイズ (ビット)	概要
7:4	予約済み	4	使用しないでください
3	I_ACC_CH	1	1：Accessory Present (アクセサリ検出) から Audio Accessory (オーディオアクセサリ) あるいは Debug Accessory (デバッグアクセサリ) へ変化した際に、割り込みフラグが立てられます
2	I_BC_LVL	1	1：BC_LVL にてアドバタイズされた電流レベルに変化が生じた際に、割り込みフラグが立てられます
1	I_DETACH	1	1：デバイスまたはアクセサリがデタッチされた際に、割り込みフラグが立てられます
0	I_ATTACH	1	1：種類レジスタにて指定された種類のデバイスまたはアクセサリがアタッチされた際に、割り込みフラグが立てられます

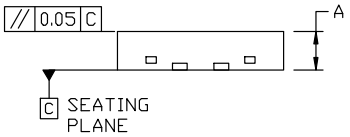


X2QFN10 1.60x1.20x0.37, 0.40P
CASE 722AC
ISSUE A

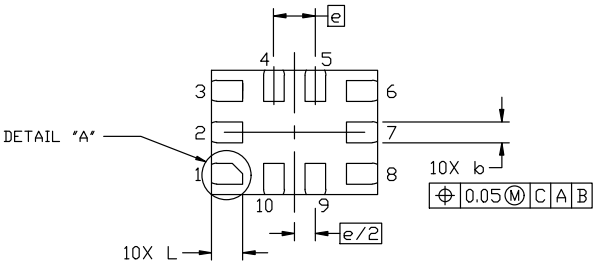
DATE 15 NOV 2023



TOP VIEW



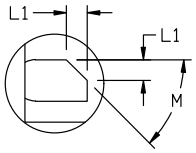
SIDE VIEW



BOTTOM VIEW

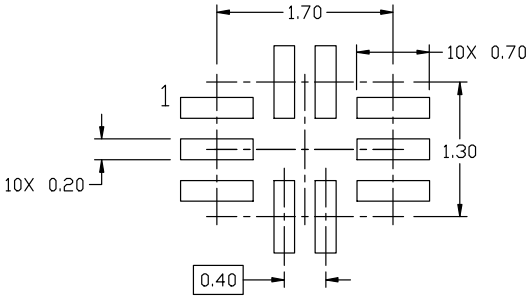
NOTES:

1. DIMENSIONS AND TOLERANCING AS PER ASME Y14.5M, 2018.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.



DETAIL "A"
SCALE 2:1

DIM	MILLIMETERS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	0.34	0.37	0.40
b	0.15	0.20	0.25
D	1.60 BSC		
E	1.20 BSC		
e	0.40 BSC		
L	0.25	0.30	0.35
L1	0.10 (REF)		
M	45° (REF)		



RECOMMENDED
MOUNTING FOOTPRINT

*FOR ADDITIONAL INFORMATION ON OUR PB-FREE STRATEGY AND SOLDERING DETAILS, PLEASE DOWNLOAD THE ON SEMICONDUCTOR SOLDERING AND MOUNTING TECHNIQUES REFERENCES MANUAL, SOLDERRM/D.

DOCUMENT NUMBER:	**98AON13692G**	Electronic versions are uncontrolled except when accessed directly from the Document Repository. Printed versions are uncontrolled except when stamped "CONTROLLED COPY" in red.
DESCRIPTION:	**X2QFN10 1.60x1.20x0.37, 0.40P**	**PAGE 1 OF 1**

onsemi and onsemi are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC dba **onsemi** or its subsidiaries in the United States and/or other countries. **onsemi** reserves the right to make changes without further notice to any products herein. **onsemi** makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does **onsemi** assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. **onsemi** does not convey any license under its patent rights nor the rights of others.

onsemi, onsemi, and other names, marks, and brands are registered and/or common law trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC dba "**onsemi**" or its affiliates and/or subsidiaries in the United States and/or other countries. **onsemi** owns the rights to a number of patents, trademarks, copyrights, trade secrets, and other intellectual property. A listing of **onsemi**'s product/patent coverage may be accessed at www.onsemi.com/site/pdf/Patent−Marking.pdf. **onsemi** reserves the right to make changes at any time to any products or information herein, without notice. The information herein is provided "as−is" and **onsemi** makes no warranty, representation or guarantee regarding the accuracy of the information, product features, availability, functionality, or suitability of its products for any particular purpose, nor does **onsemi** assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. Buyer is responsible for its products and applications using **onsemi** products, including compliance with all laws, regulations and safety requirements or standards, regardless of any support or applications information provided by **onsemi**. "Typical" parameters which may be provided in **onsemi** data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. All operating parameters, including "Typicals" must be validated for each customer application by customer's technical experts. **onsemi** does not convey any license under any of its intellectual property rights nor the rights of others. **onsemi** products are not designed, intended, or authorized for use as a critical component in life support systems or any FDA Class 3 medical devices or medical devices with a same or similar classification in a foreign jurisdiction or any devices intended for implantation in the human body. Should Buyer purchase or use **onsemi** products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold **onsemi** and its officers, employees, subsidiaries, affiliates, and distributors harmless against all claims, costs, damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that **onsemi** was negligent regarding the design or manufacture of the part. **onsemi** is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. This literature is subject to all applicable copyright laws and is not for resale in any manner.

ADDITIONAL INFORMATION

TECHNICAL PUBLICATIONS:
Technical Library: www.onsemi.com/design/resources/technical−documentation
onsemi Website: www.onsemi.com

ONLINE SUPPORT: www.onsemi.com/support
For additional information, please contact your local Sales Representative at
www.onsemi.com/support/sales